

Informationen über das Leistungsspektrum der TSE Dresden GmbH

Die TSE Dresden GmbH ist zertifiziert gemäß dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2008. Sie realisiert im Auftrag ihrer Kunden die RoHS- konforme sowie bleihaltige Fertigung in verschiedenen Aufbau- und Verbindungstechniken.

Sie bestückt auf Ein- und Mehrlagenleiterplatten bis hin zu Starr-Flex Leiterplatten. Die Fertigung der TSE Dresden GmbH arbeitet gemäß der IPC-A-610 Norm. Alle Produktionsbereiche sind ESD-gerecht gestaltet.

Professionelle Fertigungsdienstleistungen

- Logistik
 - Internationaler Einkauf zur Sicherung der Bauelementedeckung pro Auftrag
 - Internes Supply-Chain-Management (SCM) bis zur Lieferung
 - Traceability und Etikettierung der Baugruppen
 - Lagerservice der Kundenprodukte

- Entwicklungsleistung
 - Unterstützung bei der Optimierung des Leiterplattenlayouts
 - Alternative Bauelementeauswahl
 - Einsatz normgerechter ESD- und Pendel-Verpackungen

- Prototyping/Vorserien
 - Grundsätzliche Erstellung eines EMPB
 - Prüfung der Baugruppen auf Einhaltung fertigungstechnologischer Richtlinien
 - Einsatz kostengünstiger Musterbauschablonen für den automatisierten Lotpastendruck (max. Platinenmaße: 196mm x 296mm)

- Serienfertigung
 - Fertigung in flexiblen Produktionslosen für Groß-, Mittel- oder Kleinserien



Zertifiziert nach ISO 9001 : 2008

- Gerätemontage
 - Einbau und Montage der bestückten Baugruppe in unterschiedliche Systemgehäuse
 - Kabel- und Stecker montagen in kundenspezifische Gehäuseteile
- Baugruppenprüfung
 - In-Circuit-Test mit individuellem Prüfadapter
 - Funktionstest
 - IC-Programmierung (EPROM,EEPROM,GAL's,MC's)
 - Hochspannungs- und Isolationstest
 - Schutzleitertest
- Serviceleistungen
 - Reparatur von 'Feldrückläufern' (After-Sales-Service)
 - Reworkarbeiten auf Baugruppen aus Fremdfertigung
- SMT-Bestückung
 - Bestückung mit Bauteilen der Bauformen ab 0201 sowie u.a. QFN,BGA, μ BGA,CSP, Finepitch-IC's, Kontaktleisten
 - Durchgängiger Fertigungsprozess mit Schablonendruck für Lotpaste und Kleber
 - Umluft-Reflow-Lötprozess
- THT-Bestückung
 - Bauteile in Durchstecktechnik werden konventionell gesetzt
 - Verwendete Technologien sind das RoHS-konforme sowie verbleite Hand- und Wellenlöt
- Oberflächenversiegelung
 - Manuelle Baugruppenlackierung komplett



Zertifiziert nach ISO 9001 : 2008

Informationen über das Ausrüstungsspektrum der TSE Dresden GmbH

Dieses Blatt gibt Ihnen einen Überblick über die im Fertigungsprozess befindlichen Ausrüstungen bei der TSE Dresden GmbH. Durch die moderne SMT- Produktionslinie werden die Platinen rationell und sicher bestückt.

Die SMT-Technologie für Platinenmaße inkl. Rand:

- max. 300x410 / mind. 90x90, sonst Nutzen oder 'Trägerboard'
 - DEK Horizon 03i inline für Lotpasten- und SMD-Kleber
 - UNIVERSAL AdVantisX AS7 Bestückautomat
 - UNIVERSAL AdVantis 3AC-30S -Bestückautomat
 - Rehm V6 Reflow- Konvektionsofen
 - PTP® (Professional Temperatur Profiler)-Messsystem zur Anlagenprüfung gem. ISO9001 bzw. Lötprofil-Optimierung



Die THT-Technologie für Platinenmaße inkl. Rand:

- max. 250x430
 - KIRSTEN M3560 für bleifreies Wellen-Löten unter N₂
 - SEHO Nitrogenius für verbleites Wellen-Löten unter N₂
 - ROYONIC Lichtpunktbestücktische
 - PTP® (Professional Temperatur Profiler)-Messsystem zur Anlagenprüfung gem. ISO9001 bzw. Lötprofil-Optimierung



Die Handfertigung u.a. für Sonderbauformen:

- Infrarot- Reworkstation Xytronic für SMD- und BGA-Bauelemente
- WELLER Handlötstationen u.a. mit Heißluft
- JBC- Handlötstationen mit elektronisch geregelten Temperaturprofil
- Wärmeschrank WSU400
- Nutzen- und Stegtrenner
- diverse Macroskope, Mikroskope, Lupen



Prüfung und Programmierung:

- Hochspannungs- und Isolationstest bis 5kV; DC/AC
- Programmierung auf DATA iO (u.a. EPROM, EEPROM, GAL's und MC's)
- In-Circuit-Test mit individuellem Prüfadapter auf IRF für max. 1280 Testpunkte

Zertifiziert nach ISO 9001 : 2008